LAGENAUFBAU HDI (Standard)

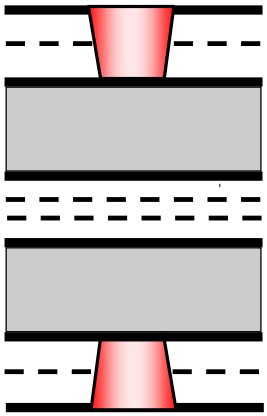
HDI06_1+4+1_1,00_35

6 - Lagen

Kerne: 0,30 mm Cu 35/35 µm

WE-Artikel Nr.:		**1 + 4 + 1**
KUNDE:		

WÜRTH ELEKTRONIK

LAGENBEZEICHNUNG		AUFBAU	BASIS-Material	CU	PREPREG ANZAHL/TYP	ENDDICKE	KUNDEN-FORDERUNG
KUNDE	WE					[µm]	[µm]
	TOP/VS		Folie	12 µm	1)	12	
					1 x 1080	**60**	
	2			35 µm		**33**	
			0,300 mm			**300**	
	3			35 µm		**33**	
					2 x 1080	**124**	
	4			35 µm		**33**	
			0,300 mm			**300**	
	5			35 µm		**33**	
					1 x 1080	**60**	
	BOT/RS		Folie	12 µm	1)	12	

1) Kupferenddicke Außenlagen ca. 50 µm

					Gesamtdicke Material:	1000	

Anmerkung: Werte für Prepreg sind Mittelwerte (der genaue Wert ist von den Leiterbildstrukturen abhängig)

MATERIALDICKE:	**1,00**	+/-	0,08	mm			Datum:	Bearbeiter:
DICKE über galv. Endoberfläche	1,08	+/-	0,11	mm				
DICKE über LSM incl.galv.-Kupfer	1,14	+/-	0,13	mm				
Kundenforderung:		+/-		mm	Messstelle:			

Erstellt am	von	Geprüft am	von	Freigegeben am	von	Revision	Seite:
05.01.2006	**S. Keller**	04.05.2006	M.Kress	05.01.2006	R. Schönholz	00	4+